



2023年5月18日

各 位

会 社 名 株式会社フジインコーポレーテッド  
代表者名 代表取締役社長 関 敬 史  
(コード番号 5 3 8 4 東証プライム、名証プレミア)  
問合せ先 財務本部長 川 島 敏 裕  
(TEL 052-503-8181)

### 「中長期経営計画2023」詳細版の公表について

2024年3月期を初年度とする6ヵ年経営計画（以下、本計画）の詳細資料を公表いたします。  
なお、本計画の概要につきましては、2023年5月10日に公表済です。

(注) 将来に関する記述等についての注意事項

当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいたものであります。従いまして、実際の業績等は、諸々の要因により見通し等とは異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。

以 上

# 中長期経営計画2023

株式会社フジインコーポレーテッド

2023年5月18日

## 内容



- ▷ 会社概要 / 当社の強み
- ▷ 前中長期経営計画の総括
- ▷ 新中長期経営計画
- ▷ マテリアリティ

## 会社概要 / 当社の強み

3

## 会社概要

(2023年3月31日現在)

会社名	株式会社フジミインコーポレーテッド
設立	1953年3月
本社	愛知県清須市西枇杷島町
事業内容	研磨材・研削材の製造、加工及び販売
株式	東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミアム市場 (証券コード：5384 上場年月：2007年2月)
売上高	583億円 (半導体比率86%、研磨比率96%)
営業利益	132億円
従業員数	1,031名(日本 732名)
拠点	国内10拠点 (愛知・岐阜：9拠点、東京：1拠点) 海外子会社5拠点 (アメリカ、台湾、マレーシア、ドイツ、中国)

4

● 事業活動を通じて、当社が認識する強みは以下の通り

▶ 半導体基板加工領域での高い市場シェア

▶ 表面加工における先進的な独自技術

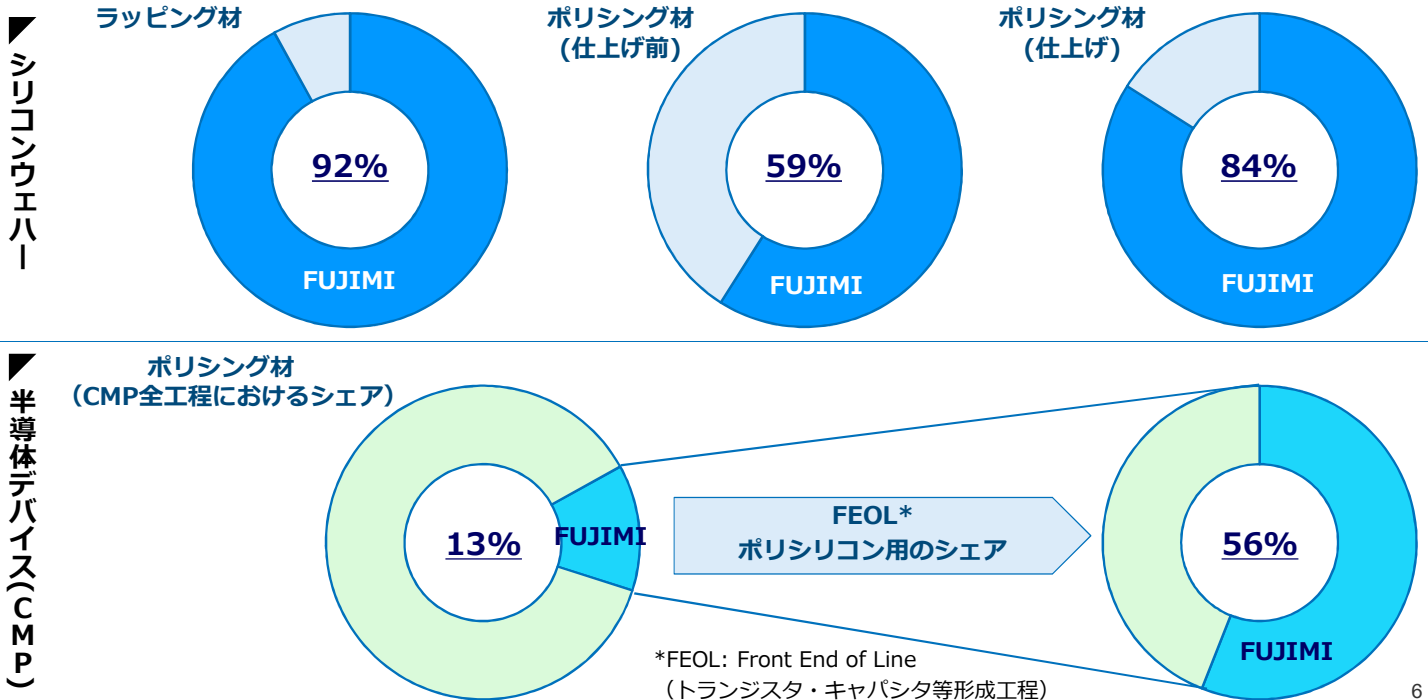
▶ 長期的な競争力維持に資する開発投資

▶ 積極的開発投資を可能とする財務力

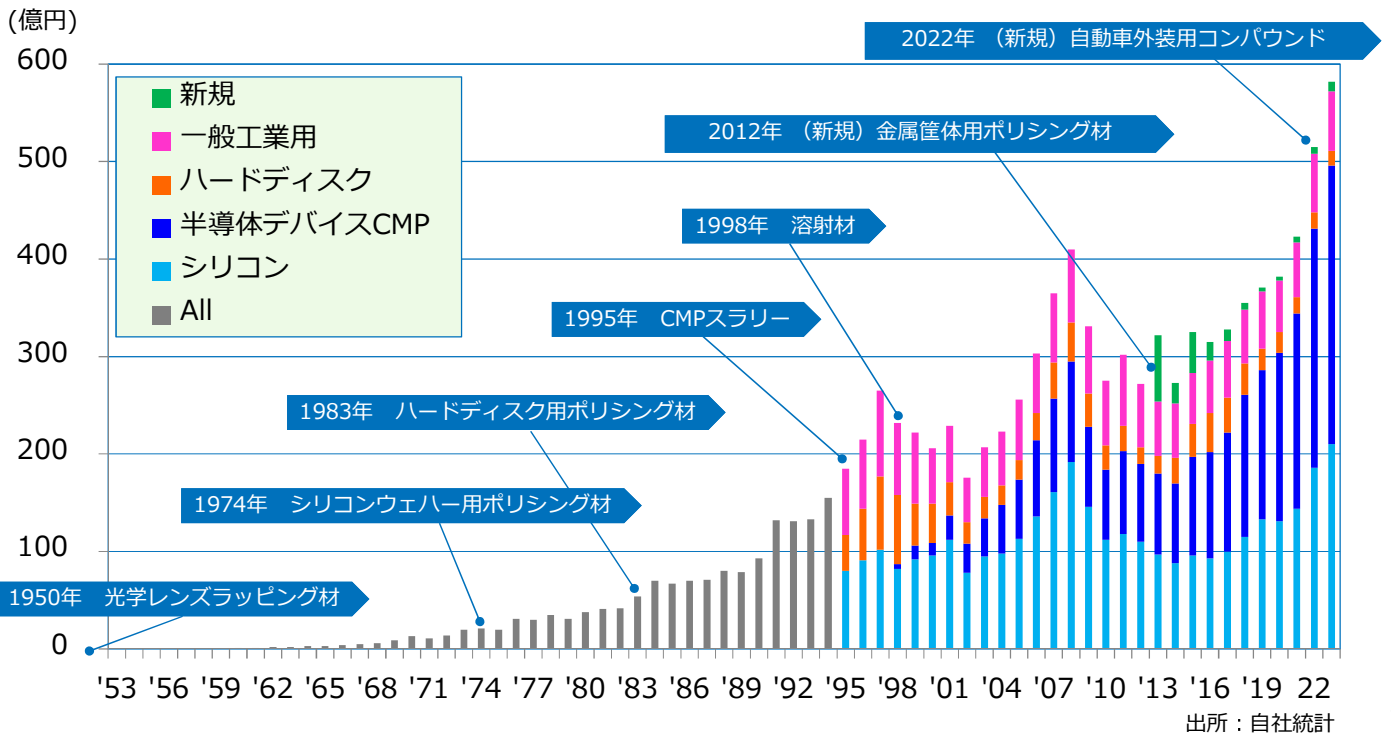
▶ 戦略的に配置された製造・販売・技術拠点

## 半導体基板加工領域での高い市場シェア

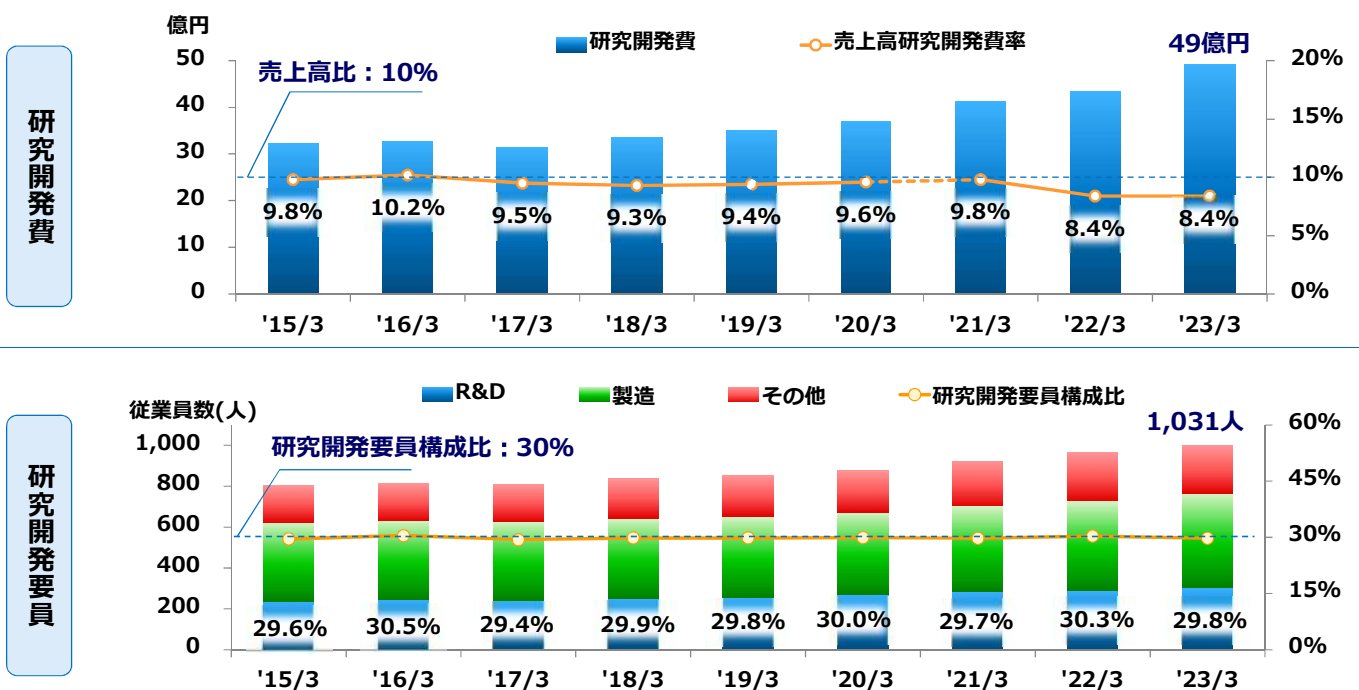
'23年3月 自社推計



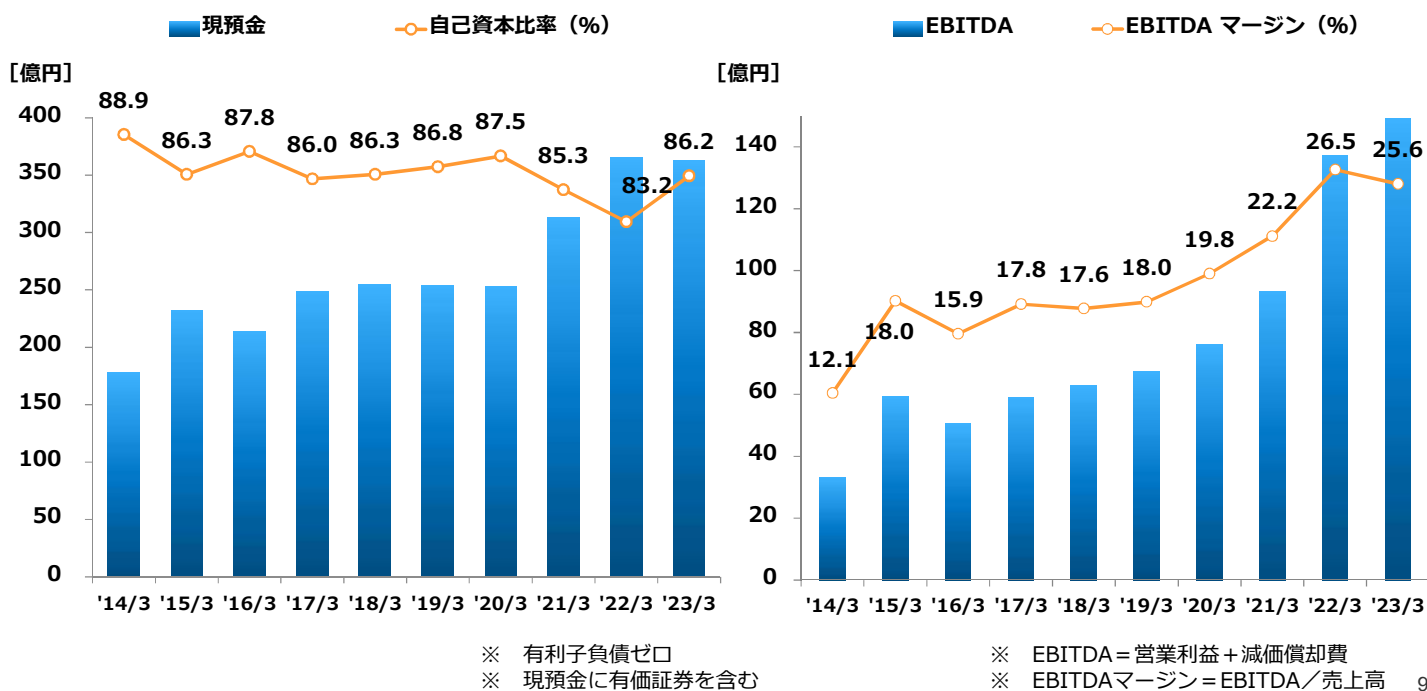
# 表面加工における先進的な独自技術



# 長期的な競争力維持に資する開発投資



# 積極的開発投資を可能とする財務力



# 戦略的に配置された製造・販売・技術拠点

- ▶ フジミ関連産業集積地に集中投資 (特にアジア・北米地域の顧客サポート体制の充実)
- ▶ 海外売上高構成比 77%

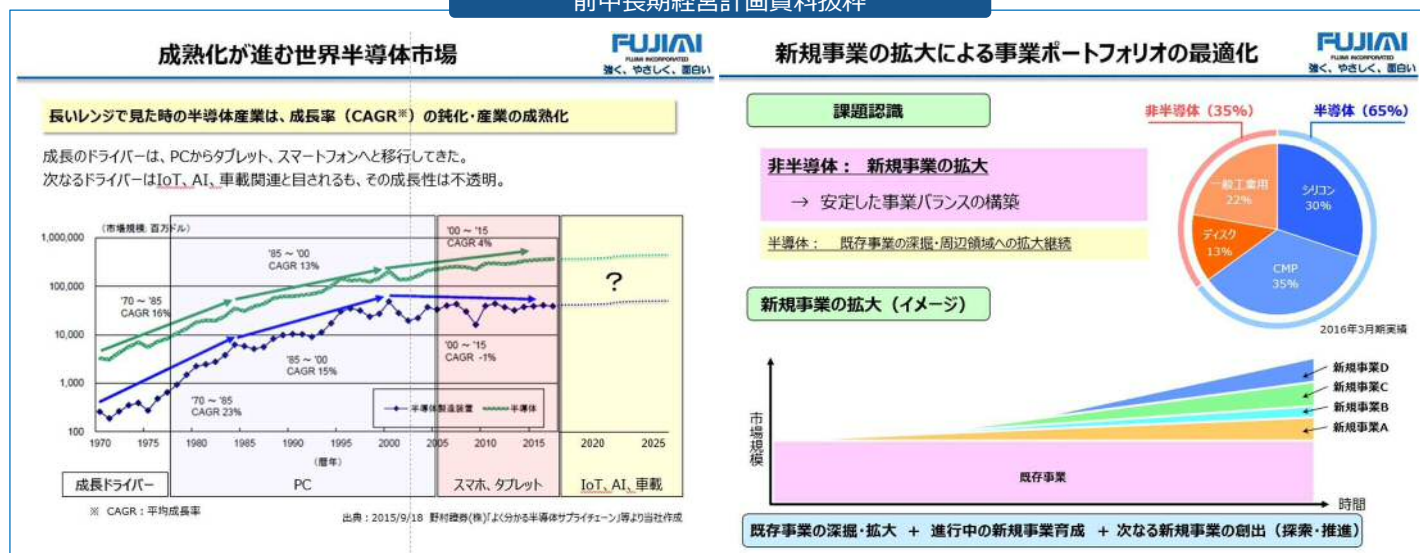


# 前中長期経営計画の総括

## 前中長期経営計画の前提

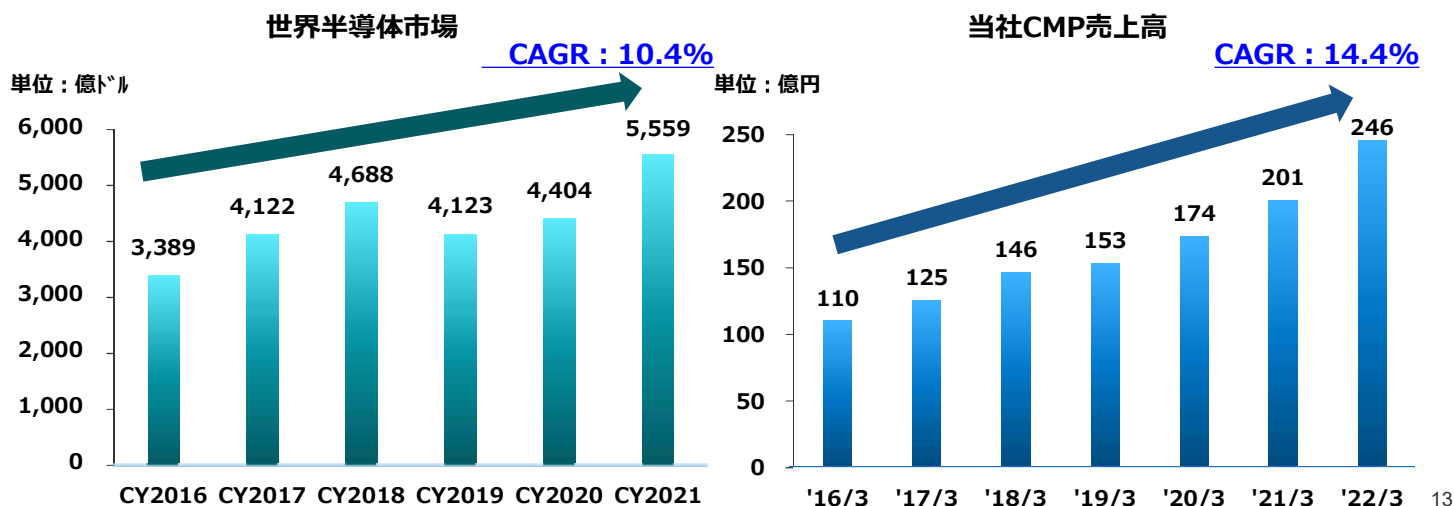
- 前中長期経営計画では、半導体市場は成熟により成長率の鈍化を想定
- 非半導体分野、非研磨分野にも注力し、事業ポートフォリオの最適化を図る計画

### 前中長期経営計画資料抜粋



## 前中長期経営計画の振返り（半導体市場）

- 半導体市場は計画期間中にメモリバブルの崩壊がありながらも、2桁成長を遂げた
- 当社CMP製品売上は、ロジック、メモリともに最先端半導体分野での採用が拡大し、世界半導体市場の成長を超える成長を遂げた



## 前中長期経営計画の振返り（KPI）

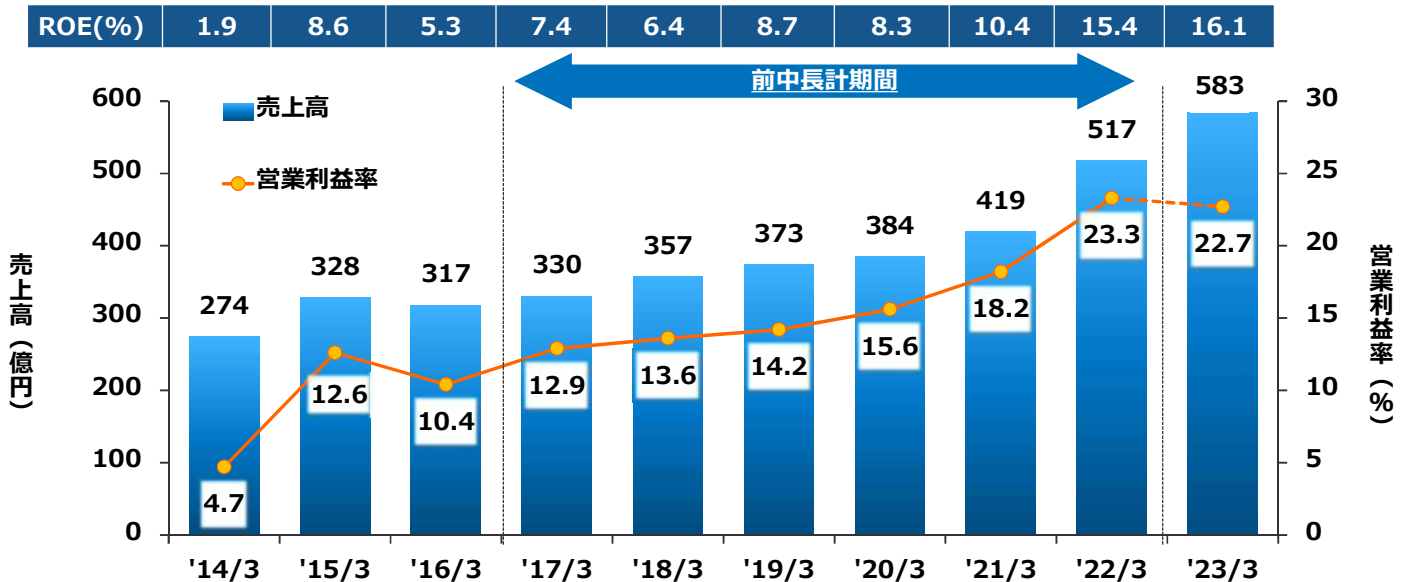
- 収益性の高い最先端半導体向け製品の売上が伸長したことから、営業利益、ROEは目標を達成
- 新規事業分野においては、金属筐体向け研磨ニーズの縮小（加工プロセス変更の為）、その他新規開発分野も開発品の採用に時間を要し、連結売上高、新事業売上構成比は目標未達

項目	計画初年度 (2017/3)	最終年度 (2022/3)		(参考) 2023/3
	実績	計画	実績	実績
連結売上高	330億円 半導体 : 237億円 非半導体 : 93億円	600億円 半導体 : 330億円 非半導体 : 270億円	517億円 (未達) 半導体 : 440億円 非半導体 : 77億円	583億円
連結営業利益率 (参考: 金額)	12.9% (42億円)	15%以上 (90億円)	23.3% (達成) (120億円)	22.7% (132億円)
新規事業売上構成比 (参考: 金額)	4% (13億円)	25%以上 (150億円以上)	2% (未達) (9億円)	2% (10億円)
非半導体向売上構成比	31%	45%以上	15% (未達)	14%
非研磨分野売上構成比	6%	15%以上	5% (未達)	4%
ROE	7.4%	10%以上	15.4% (達成)	16.1%
連結配当性向	39%	50%以上 ※2019/3を目標	49.9% ※2018/3以降、 概ね50%を維持	51.4%



# 前中長期経営計画の振り返り（ハイライト）

- ▶ 期間（2017/3~2022/3）を通じて増収増益
- ▶ ROE目標10%を1年前倒し（2021年3月期）で達成



# 前中長期経営計画の達成状況（22年3月期末）

各事業の取組み方向性	成果と課題
<b>半導体分野</b>	
▶ シリコン 次世代半導体に対応	<b>【成果】</b> SiCパワー半導体向け大手顧客にてPOR獲得 <small>※23/3期現在、量産使用開始</small> <b>【課題】</b> SiC新規顧客の採用獲得による市場シェア拡大
▶ CMP 5ナノ以降の半導体に対応	<b>【成果】</b> 主要顧客の先端プロセスで採用獲得 <b>【課題】</b> 先端分野の要求に対応できる品質管理能力向上 サプライチェーンマネジメントの強化 実装分野における顧客密着型製品開発による事業機会獲得
<b>非半導体分野</b>	
▶ 機能材 パウダー領域の用途拡大	<b>【成果】</b> 機能性セラミックスパウダー、セラミックス複合材料、リン酸チタン新規パウダーの開発 <b>【課題】</b> 新市場でのシーズ発信力強化、新製品の上市
▶ 溶射材 複合技術等に事業領域拡大	<b>【成果】</b> 一部顧客にて3Dプリンター材の実機評価開始 <b>【課題】</b> 新市場でのシーズ発信力強化、新製品の上市 先端半導体製造装置向け製品のシェア拡大
▶ 研磨ソリューション 平面から複雑形状研磨、新研磨手法、ソリューション提供	<b>【成果】</b> 自動車用研磨コンパウンドの上市、全自動ロボット研磨システム、磁性流体研磨の開発 <b>【課題】</b> 研磨ニーズ探索とインキュベーション機能強化
▶ 他社との事業提携・資本提携 M & Aの実施	<b>【成果】</b> CVC及び自社で合計6社に出資 <b>【課題】</b> パウダー&サーフェスカンパニーの実現に向けたM&A推進

全社成長戦略の方向性	成果と課題
<p>▼ <b>事業ドメインの再認識</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ パウダー＆サーフェス領域の拡充</li> <li>▷ 研磨材メーカーからパウダー＆サーフェスカンパニーへ</li> </ul>	<p><b>【成果】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 半導体関連事業（シリコン・CMP）の成長</li> <li>• 非半導体・非研磨領域への積極的資源投下</li> <li>• 事業フィールド導入による機動的な事業運営体制の強化</li> </ul> <p><b>【課題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中長期視点での非半導体・非研磨領域の継続開拓</li> </ul>
<p>▼ <b>新規用途拡充・新規事業育成</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 既存事業での深堀と新規用途の発掘（短期～中期）</li> <li>▷ 非研磨用途・非研磨事業の拡充（中期）</li> <li>▷ 10年後を見据えた長期的視点での育成（長期）</li> </ul>	<p><b>【成果】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 先端・次世代半導体向け新規開発品の採用</li> <li>• コア技術をベースとした非研磨・非半導体向け製品の開発</li> <li>• 新たな立体研磨手法の確立によるソリューションビジネス推進</li> </ul> <p><b>【課題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高度化する顧客要求に応える品質管理能力の維持・向上</li> <li>• 新市場でのシーズ発信力強化</li> </ul>
<p>▼ <b>積極的なR&amp;D投資と他社との事業連携</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 既存事業の深堀と中長期的成長への投資</li> <li>▷ 素材設計能力の強化</li> <li>▷ 積極的な他社との連携およびM&amp;A</li> </ul>	<p><b>【成果】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 先端半導体向け製造ライン拡張</li> <li>• 先端技術研究所の設立による既存事業の基盤技術の深耕・強化</li> </ul> <p><b>【課題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 半導体需要増加を見据えた製品供給体制の拡充</li> <li>• 新製品開発促進のための研究開発環境の整備・拡張</li> <li>• パウダー＆サーフェスカンパニーの実現に向けたM&amp;A推進</li> </ul>

17

## 新中長期経営計画

当社は、企業使命である「高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します」に基づき、既存事業（半導体関連事業等）の更なる拡大と新たな柱となる新規事業の創出を通じて、研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化を遂げ、持続可能な社会の実現への貢献を目指すことを基本方針としております。

2024年3月期から2029年3月期の6年間を対象とする本計画では、研究開発とグローバルな製品供給体制の拡充に一層の経営資源を投入するとともに、サステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに係る取組みを積極的に推し進め、中長期企業ビジョン・スローガン「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」の実現に向け、各種施策等を策定いたしました。

- ▶ 当計画期間中はデータセンター、自動車、産業機械向けを中心に半導体市場の伸長が見込まれる
- ▶ しかし、コロナ禍を契機に急速に進んだデジタル化により半導体市場が想定以上に拡大した一方、足元ではその反動を受けるなど半導体市場はシクリカルであり、持続的な成長には非半導体分野の育成が重要

マクロ	半導体	当社への影響
世界経済の不透明感	▶ 世界経済と半導体市場は密接な相関あり	▶ 売上の8割以上を半導体向けが占め、業績ボラティリティ拡大
米中間の緊張	▶ CHIPS法の運用厳格化により、中国での最先端製品の製造、同国への最先端製品導入に制限	▶ 中国半導体向け売上の停滞リスク ※ 当社は同市場に対して積極的な拡大を控えてきた ▶ 最先端品の製造は、米、欧、中国を除くアジアを中心に、地産地消の流れが進む。当社は日本・米国・台湾の3拠点戦略で対応
環境問題への対応	▶ 動作性能とともに、低電力消費性能に優れた微細化の進展 ▶ 低電力損失性能に優れたパワー半導体市場の拡大	▶ 先端半導体向けで高いシェアを誇る当社にはポジティブ一方で、開発、製造、品質への要求はますます高度化 ▶ パワー半導体向けは大きな成長が見込まれる分野であり、当社の研磨総合力を投入

# 新中長期経営計画（定量目標）

■ 収益性確保を図りつつ、2030年に連結売上高1,000億円を目指す

目標項目	2023年 3月期	2024年 3月期	2026年 3月期	2029年 3月期	
	実績	期初予想	計画	計画	
連結売上高	583億円	585億円	770億円	950億円	(売上高) ▷ 計画初年度からのCAGRは、10% ▷ 各構成比は、将来に向けて持続的な成長を遂げるため、現状からの大幅な上昇を目指す
新規事業売上構成比	2.0%	3%	15%	20%	
非半導体売上構成比	14.0%	15%	20%	25%	(収益性) ▷ 減価償却費と研究開発費の増加により、営業利益率は低下するもEBITDAマージンは上昇を目指す ▷ 減価償却費のピークは2029/3期を見込む
非研磨分野売上構成比	4.4%	5%	8%	10%	
営業利益率	22.7%	21.4%	20%	20%	(資本効率) ▷ ROEは、15%以上を目指す
EBITDAマージン	25.6%	25.0%	26%	27%	
ROE	16.1%	13.9%	15%	15%	

(配当方針) 連結配当性向55%以上を目標、安定配当の継続にも留意。DOEを配当の指標に加えることを検討する。  
(2023年5月10日プレスリリース抜粋)

## 重要施策

■ 基本方針に基づき、本計画期間中に取り組む重要施策は以下のとおり

### 1. 研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化を実現する新規事業の創出

- ✓ 独自技術の強みを活かしたマーケティング体制の強化
- ✓ 機能性材料での独創的な高付加価値提供
- ✓ 加工ソリューション提供であらゆる表面創生を実現
- ✓ 新規事業の創出及び成長に必要な技術獲得に向けたM&Aの推進

### 2. 半導体関連事業の強靱な基盤構築と次世代半導体向け材料分野での圧倒的な地位確立

- ✓ 中長期的な半導体需要の拡大を見据えたグローバルな製品供給体制の拡充
- ✓ 半導体プロセスの高度化に応える業界トップ水準の研究開発・品質保証力の維持・向上
- ✓ 次世代半導体の高機能化・多機能化を実現する実装基板向け材料の開発推進
- ✓ 脱炭素社会実現の鍵となるSiC、GaNパワー半導体向け研磨材の主要サプライヤーへの成長

### 3. コア技術の発展と新技術の開発

- ✓ コア技術（ろ過・分級・精製技術、パウダー技術、ケミカル技術）の更なる発展
- ✓ 顧客価値創造を実現する革新的新技術開発への挑戦

▼ 基本方針に基づき、本計画期間中に取り組む重要施策は以下のとおり

## 4. 100年企業を実現するGRIT（※）な組織と人づくりへの挑戦

- ✓ ものづくりの誇りを次代に受け継ぐ、揺るぎないインテグリティマインドの確立
- ✓ 働きやすさ、働きがいを実感できる組織文化の醸成とウェルビーイングの実現
- ✓ お客様目線を実践するプロフェッショナルの育成
- ✓ 切磋琢磨する最高のチームワーク創出

※ GRIT：困難な状態にも挫けることなく、目標に向かって最後までやり抜くこと

## 5. サステナビリティ経営の実践

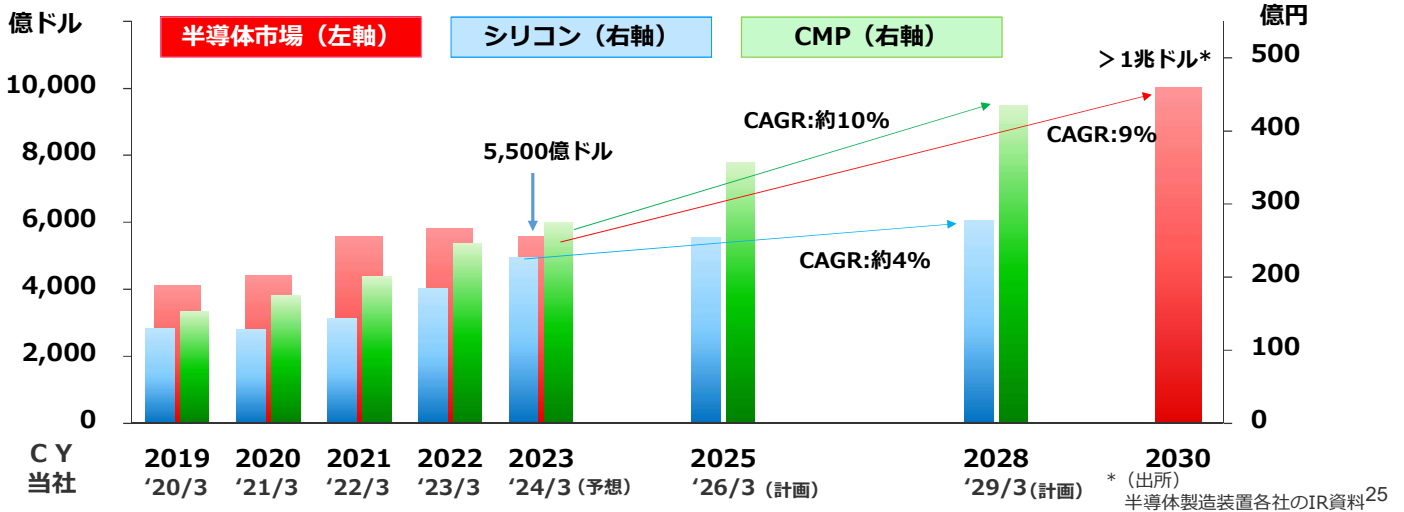
- ✓ 気候変動をはじめとした環境問題解決への積極的な貢献
- ✓ リスク管理・サプライチェーンマネジメントを軸とした事業継続力の強化
- ✓ グローバルな事業活動を支えるガバナンス体制の強化
- ✓ サステナビリティ向上に資する価値創造活動の推進

# 各事業の取組み

	区分	目指す姿	取組みの方向性
半 導 体	CMP	世界トップのFEOLスラリーメーカー	先端顧客の期待に応える品質・技術の確立と日・米・台3拠点体制による強みの極大化
	シリコン	シリコンウェハー向け研磨材のリーディングカンパニー	独自技術の確立（原料設計、配合・精製技術）による顧客毎の研磨加工プロセスのソリューション提供
	実装基板	実装基板向け材料分野での事業機会獲得	先端パッケージ技術に対応した顧客密着型製品開発の推進
	SiC	SiCパワー半導体向け研磨材の主要サプライヤー	コア技術を基盤とした新技術の確立と高効率性を有する製品投入によるマーケットシェアの拡大
	溶射	溶射材市場でのシェア拡大	複合技術を活用したソリューション提供による顧客価値の創造（半導体）先端半導体製造装置向け製品の開発パートナー地位の確立（非半導体）事業の柱となる未参入、新規の有望案件の発掘と獲得
非 半 導 体	ディスク	市場シェア奪回によるメインプレイヤーへの返り咲き	開発能力の強化と顧客への技術サポート体制の充実による製品競争力の強化
	研磨ソリューション	研磨ソリューション領域での新規事業の創出	自動車用研磨コンパウンドを始め、お客様のウォンツに応える先進の研磨ソリューションの提供
	先端技術・機能材料	パウダー領域での新規事業の創出	独自の技術マーケティング力とパウダー技術を駆使した機能性材料（セラミックスパウダー、セラミックス複合材、新規パウダー等）の開発継続・事業化

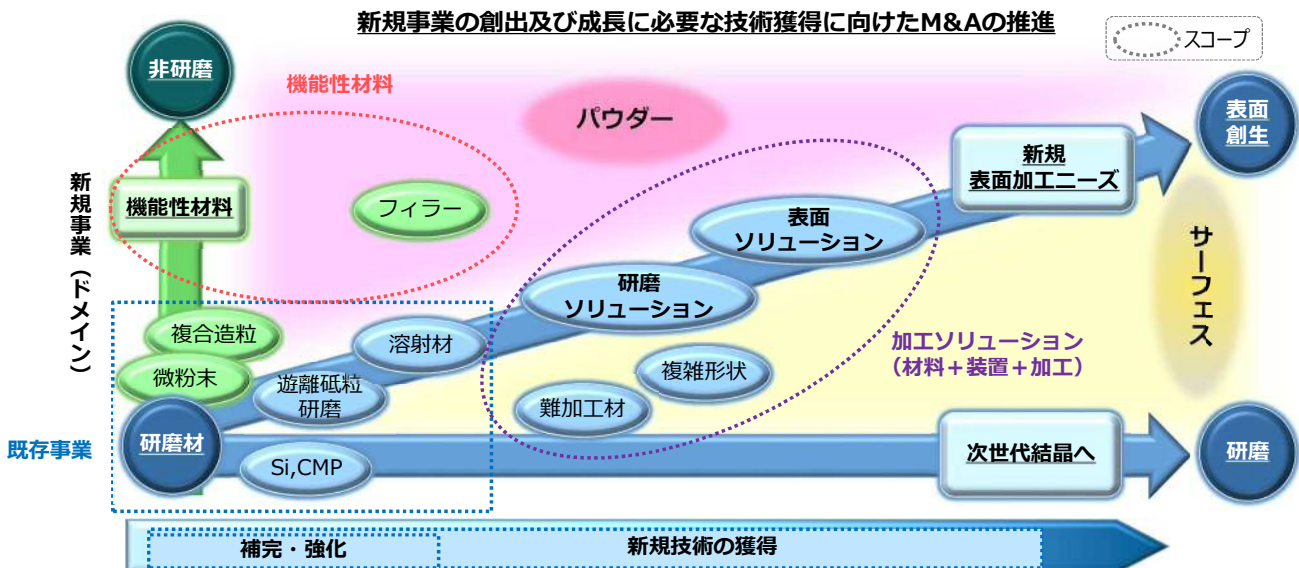
# 半導体市場・当社半導体関連事業

- 半導体市場は、データセンター、自動車、産業機械向けを成長ドライバーとして、2030年には1兆円ドルを超える見通し
- 当社半導体向け製品については、顧客ごとに増産計画を調査し、当社使用量及び使用量の削減等を織り込み算出
- 半導体市場のCAGR 9% (CY2023~2030) に対し、当社CMP製品は約10%、シリコンは約4% (いずれも2024/3~2029/3) を想定



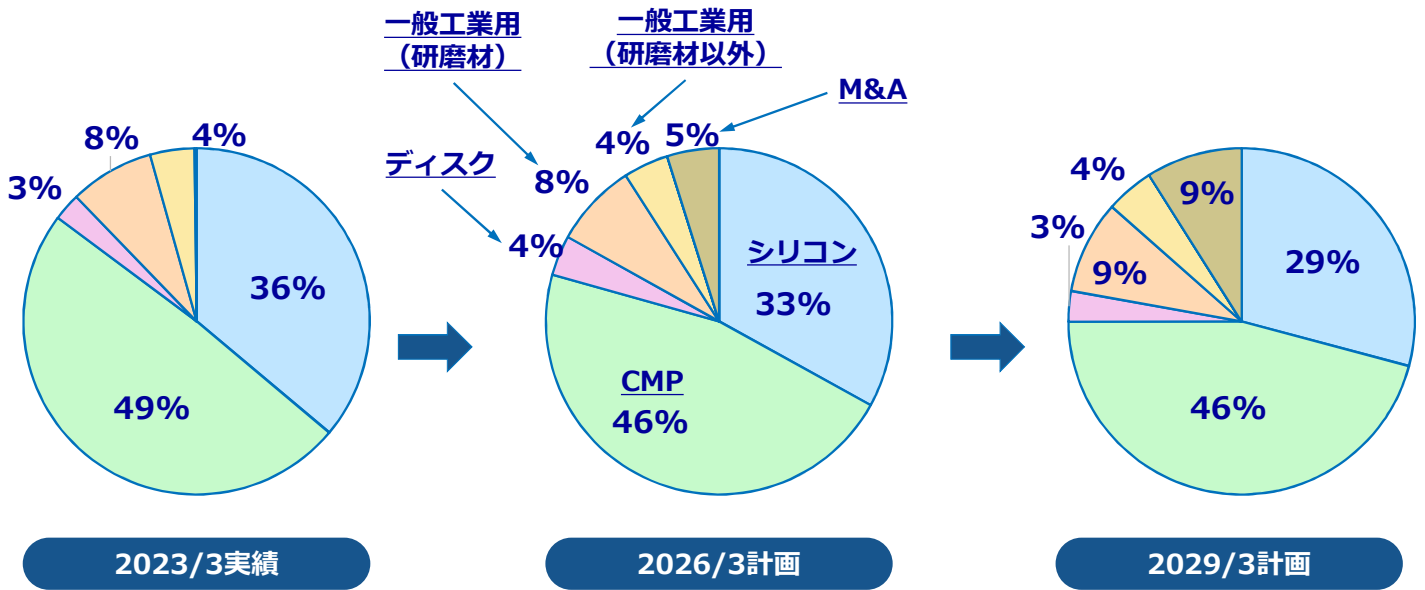
## 成長の方向性

- 新規事業の創出及び成長に必要な技術獲得に向けたM&Aの推進
- 新たな表面加工ニーズ、新たな機能性パウダー分野をスコープとする





# 用途別売上高

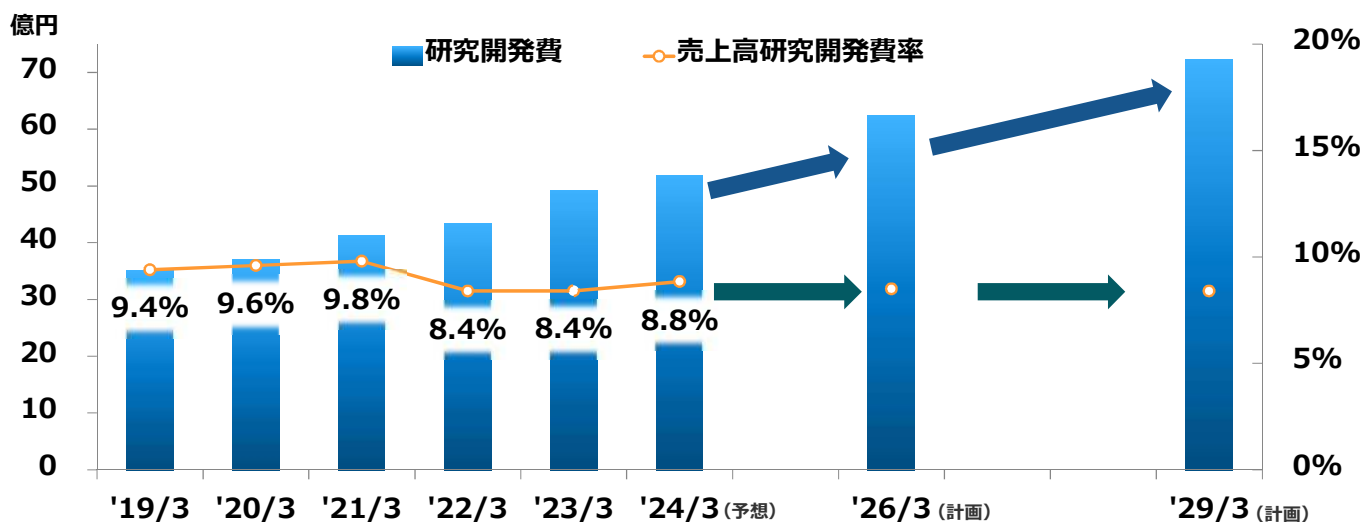


# 売上高構成比 (新規・非半導体・非研磨)

	'23/3実績	'26/3計画	'29/3計画	成長ドライバー
新規事業	2% (新規) 98% (既存)	15% (新規) 85% (既存)	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体関連：SiC、実装</li> <li>一般工業用研磨材：自動車外装向け</li> <li>〃非研磨材：セラミックス粉末/焼結体 3Dプリンター向け超硬材</li> <li>M&amp;A</li> </ul>
非半導体向け	14%	20% (非半導体) 80% (半導体)	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般工業用研磨材：自動車外装向け</li> <li>〃非研磨材：セラミックス粉末/焼結体 3Dプリンター向け超硬材</li> <li>M&amp;A</li> </ul>
非研磨分野向け	4%	8% (非研磨) 92% (研磨)	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般工業用非研磨材：セラミックス粉末/焼結体 3Dプリンター向け超硬材</li> <li>M&amp;A</li> </ul>

## 研究開発費

過去は10%前後であった売上高R&D比率は、売上増加に伴い8%台まで低下するも、半導体微細化に追随するためのRD施設拡張、最先端研究開発設備機器（評価装置、研磨装置他）導入、コア技術強化・新技術確立のための新RDセンター建設により、研究開発費はCAGR約9%で増加



※ M&A先の研究開発費は含まず。

## 大型投資計画

世界各国が半導体を戦略物資とみなし、その地産地消を目指して大規模な投資、生産を進める流れに対し、当社は日・米・台3拠点の開発、製造、品質保証体制で対応

### フジミインコーポレーテッド (岐阜県)

- 新工場建設 (CMP、シリコン用スラリー)
- 既存工場増設による増加 ( " )
- 老朽施設の改修とともに事業構造転換を推進
- 新RDセンター建設 (主に新規事業開発向け)

### フジミ台湾 (苗栗県)

- 新生産ライン導入 (CMP用スラリー)
- 台湾半導体デバイスメーカーの次世代最先端、最先端半導体製造能力増強に対応
- 米国向け一部製品をカバー

### フジミコーポレーション (オレゴン州)

- 新工場棟建設 (CMP用スラリー)
- 米国内の米国、台湾半導体デバイスメーカーの最先端半導体製造能力増強に対応



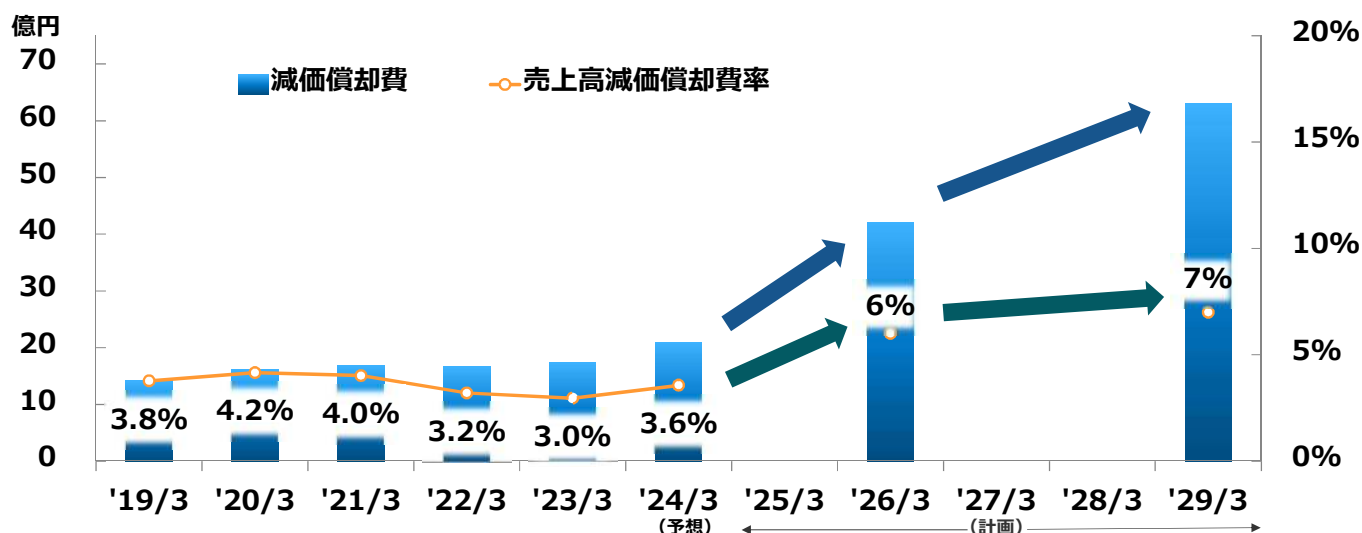
## 投資計画

設備投資に関しては、ここ数年、年間20億円前後で推移してきたが、中期的な半導体需要の拡大を見据えたグローバルな製品供給体制の拡充、コア技術の発展と新技術の開発を確実なものとするべく、かつてない大規模な設備投資（550億円）を計画。建設資材価格、人件費が高騰しており、過去の工場建設と比較して、投資額は大幅な増額を見込む

	'18/3~'23/3 6カ年累計（実績）	'24/3~'29/3 6カ年累計（計画）		
			'24/3~'26/3 3カ年累計	'27/3~'29/3 3カ年累計
設備投資	投資CF127億円のうち、 <b>112億円</b>	<b>550億円</b>	<b>300億円</b>	<b>250億円</b>

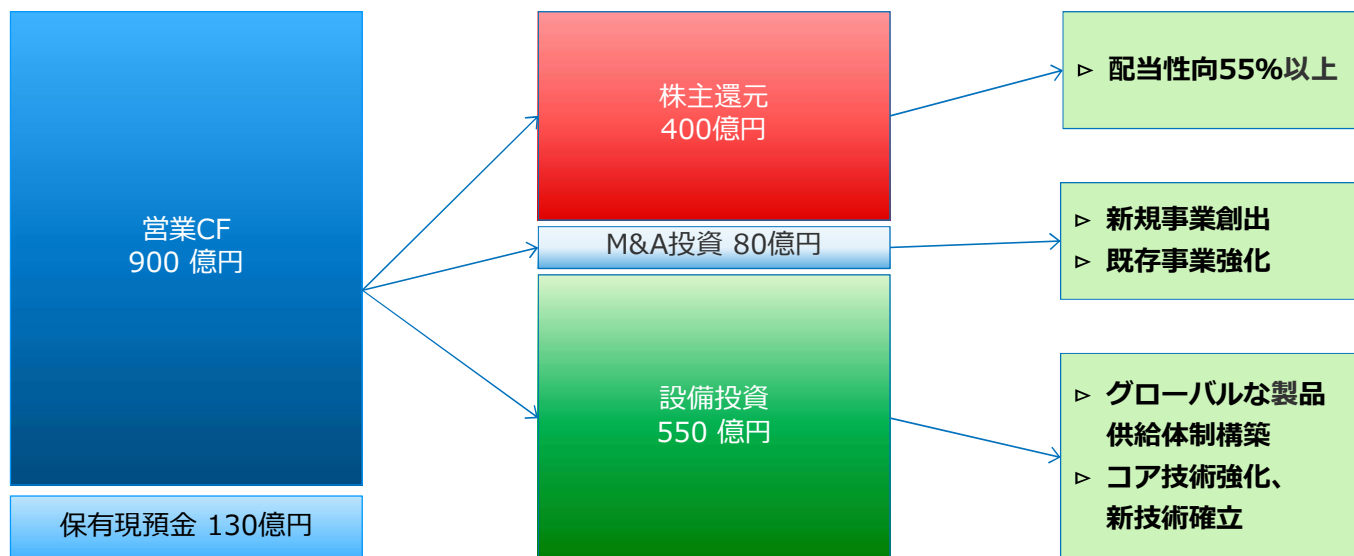
## 減価償却費

3%~5%で推移していた売上高減価償却費率は、グローバルで安定的な製品供給体制の拡充のための新工場建設・生産能力増強、半導体微細化に追随するためのRD施設拡張、最先端研究開発設備機器（評価装置、研磨装置他）導入、コア技術強化・新技術確立のための新RDセンター建設により、減価償却費はCAGR17%と大きく増加



## 資金配分イメージ（6年間累計）

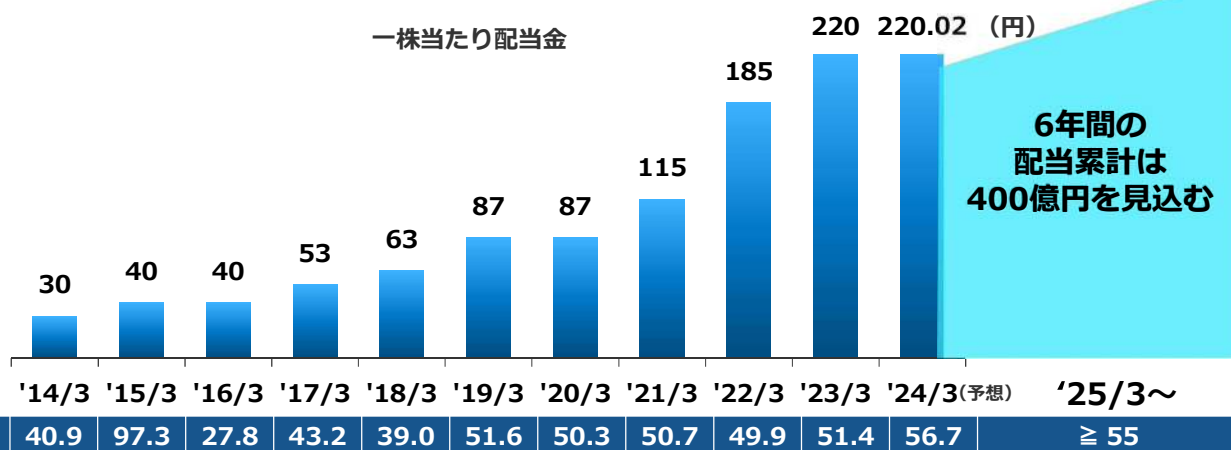
- 半導体向け（CMP、シリコン）で創出した営業CFを、更なる需要拡大を見据え、グローバルな製品供給体制の拡充、コア技術の強化・新技術確立の中核となる開発に投下するとともに、積極的な株主還元を実現



33

## 還元の変遷と新還元方針

- 株主還元を一段強化
  - ▷ 変更後：連結配当性向 55%以上を目標
  - ▷ 変更前： " 50%以上を目標
- 安定配当の継続にも留意し、DOEを配当の指標に加えることも検討する（2023年5月10日プレスリリース抜粋）



34

## マテリアリティ

35

### マテリアリティ（重要課題）の特定の背景

- ▶ 当社は第7次中長期経営計画策定に際し、持続的可能な社会の実現に向けて、当社が優先して取り組む重要な課題として18のマテリアリティ（重要課題）（以下「マテリアリティ」と称する）を特定致しました。
- ▶ 当社では従前より企業使命に「高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します」を掲げ、社会への貢献と持続可能な事業成長の両立に努めて参りました。
- ▶ 今般、マテリアリティを特定することで、自社が貢献すべき社会課題を認識し、課題への取組みを進めて参ります。今後は社会動向・自社の取組状況を踏まえて、定期的にマテリアリティを更新する予定です。

36

# マテリアリティの特定プロセス

Step1	ESGの視点から社会課題を網羅的に洗い出し、当社の課題を抽出 その後、当社にとっての重要度を検証
Step2	ステークホルダーインタビューを実施し、社会にとっての重要度を検証
Step3	自社にとっての重要度と社会にとっての重要度に基づき、課題を環境（E）・ 社会（S）・ガバナンス（G）・価値創造の4分類に分け、優先順位付けを実施
Step4	当社企業使命との整合性を確認し、当社のマテリアリティを特定
Step5	取締役会において審議・承認

# マテリアリティ・マトリックス



## 18のマテリアリティ

**E**  
(環境)

- 気候変動対応
- 水資源保全
- 循環型社会への貢献
- 化学物質管理

**S**  
(社会)

- 労働安全衛生の確保
- ウェルビーイング実現
- ダイバーシティ推進と人材育成
- 地域社会貢献

**G**  
(ガバナンス)

- インテグリティ
- 情報セキュリティマネジメント
- 知的財産保護
- リスクマネジメント
- コーポレートガバナンス・コンプライアンス

価値  
創造

- サプライチェーンマネジメント
- DX推進
- 品質管理
- 研究開発
- 生産性向上

## マテリアリティの解説

環境 (E)

気候変動対応



### 【特定の背景】

気候変動への対策は世界の喫緊の課題であり、当社においても気候変動への具体的な対策が重要であると認識している。当社はこれまでも各工場に省エネ委員会を設置し、きめ細やかなエネルギー管理を図るなど、CO2排出量の削減を行ってきた。今後は拠点ごとの排出量把握や全社の中長期的な削減目標の設定を行うとともに、様々な方策を検討し環境負荷低減をより一層推進する。

環境 (E)

水資源保全



### 【特定の背景】

当社製品には生産工程で地下水を大量に使用するものがあり、水は当社の事業活動に欠かすことのできない重要な天然資源である。そのため、水使用（投入）量の削減など水資源の有効活用を徹底し、安定した事業活動の継続を行うと共に、森林保全と水源涵養（※）に努める。

※森林保全と水源涵養に関する取組みは「社会（S）地域社会貢献」の解説をご参照ください。

環境 (E)

化学物質管理



## 【特定の背景】

環境保全、人の安全、事業の継続等のために化学物質を適切に管理することは企業の重大な責務である。管理体制を強化し、また各国の規制状況を適切に把握し、関連法規制や上乘せ基準（※）の遵守を徹底する。また化学物質管理に関するお客様の要求基準にも応えるべく継続した取組みを推進する。

※ 国の法令に定められた基準に上乘せされて制定される条例、あるいは都道府県条例の基準に上乘せして制定される市区町村条例

環境 (E)

循環型社会への貢献



## 【特定の背景】

環境保全と経済発展の両立のためには、限りある資源の有効活用、廃棄物排出量の削減と再資源化および廃棄物の適正な処理に努め、循環型社会を構築していくことが重要。またサプライチェーン全体での省資源化を目指し、継続した取組みを推進する。

41

社会 (S)

労働安全衛生の確保



## 【特定の背景】

従業員の安全確保は当社の最優先事項であり、国内外の拠点において労働災害防止のための取組みを行い、労働災害の撲滅を目指す。

また、従業員の健康増進にも取組み、長時間労働の撲滅やメンタルヘルス対策の強化を進める。

災害防止と健康維持の両輪で従業員の健康を保ち、安心して働くことができるように努める。

社会 (S)

ウェルビーイング実現



## 【特定の背景】

当社は『一人ひとりが「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる会社を目指します』を経営姿勢に掲げており、今後も就業環境の改善、人事制度の見直し、ワークライフバランスへの十分な配慮等を通じて、「働きやすさ」と「働きがい」を実感できる組織文化の醸成とウェルビーイング実現に向けた取組みを継続的に推進する。

42

社会 (S)

ダイバーシティ推進と人材育成



**【特定の背景】**

多様な人材の活躍や人材育成は継続的な事業の発展において不可欠である。当社はダイバーシティ推進に向けて、性別、人種、国籍、信条、障がい等に関わらず、「働きやすさ」や「働きがい」を実感できる職場環境づくりに取り組んでいく。また、人材育成に向けて、研修等を通じた教育機会の提供、育成制度の見直しを実施しており、今後も各職階に応じた育成プログラムの拡充を継続的に図る。

社会 (S)

地域社会貢献



**【特定の背景】**

当社は国内に複数の拠点・工場を有し、地域環境に配慮した活動に努めている。また、当社製品の生産工程において大量の地下水を使用することから、生産拠点多く存在する岐阜県の河川上流域にある岐阜県郡上市白鳥町石徹白において、「Water Offset」をテーマに地域環境に貢献する活動を続けている。森林再生を通じて水源地の自然環境を守り、土壌の保水容量を維持もしくは増やす活動に地域団体と協働して取組み、今後も地域とのつながりを大切にする。

ガバナンス (G)

インテグリティ



**【特定の背景】**

当社が大切にしている「ものづくりへの誇り」のベースとなるインテグリティ（誠実、真摯であること）を強く意識し、社会規範や倫理を基に自ら考え、直面する課題や問題、業務を見つめ直し、「ものづくりへの誇り」を確固たるものにするべく、インテグリティマインドの強化を推進する。

ガバナンス (G)

コーポレートガバナンス・コンプライアンス



**【特定の背景】**

当社は、『技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応える』ことを経営姿勢として掲げている。企業が法令を遵守し公正な事業慣行を徹底することは、健全な経済発展のため、また企業の事業継続と持続的な発展に不可欠であり、コンプライアンスの徹底に取り組んでいる。コーポレートガバナンスの強化にあたっては、グローバルでのマネジメント体制の強化が重要と認識している。今後もステークホルダーとの積極的なコミュニケーションを通じて、頂いた意見を企業活動に役立てるよう努める。



ガバナンス (G)

知的財産保護

【特定の背景】

長年の研究開発を通じて培った製品・技術の知的財産は当社の重要な資産である。知的財産の確保と保護に努め、自社技術の漏洩防止および研究開発の強化などを図っていく。また、知的財産法・特許法等を遵守し、他者の知的財産を尊重する。

ガバナンス (G)

情報セキュリティマネジメント

【特定の背景】

情報セキュリティに関するリスクが増大している中、強固なセキュリティ対策を構築し、被害発生防止に努める。また、万一の場合にも、お客様への製品供給が滞ることなく、安定的に供給できるよう、非常時における管理体制の整備をより一層推進する。

ガバナンス (G)

リスクマネジメント

【特定の背景】

研磨技術により社会に不可欠な半導体産業に貢献している当社は、製品を安定的に供給することが責務である。重大インシデントの発生に備え、事前に対応策を講じることにより、事業継続性や緊急時の対応能力の向上に努めている。緊急時においても安定的に製品の供給を継続する体制を構築し、お客様の安定的な事業活動に貢献する。

価値創造

サプライチェーンマネジメント



【特定の背景】

地政学リスク、気候変動、自然災害の激甚化等により安定した原材料の調達や物流網の構築が課題となっている。安定した原材料調達や物流の確保は、事業継続やお客様への安定供給の観点から欠かせない。これらへの対策を通じて今後起こりうる事業環境変化に対し、柔軟に対応し、いかなる状況においても供給責任を果たしていく。また、原材料の調達にあたっては人権侵害や環境破壊のリスクが潜在的にあり、責任ある原材料調達に必要な対応を継続する。



### 価値創造

### 品質管理

#### 【特定の背景】

研磨技術により半導体産業に貢献する当社製品の品質はお客様の事業、ひいては一般消費者の日常生活にも影響するものと考えている。半導体の微細化が進むに伴い、日々向上する要求品質へ応えることを可能にする品質保証力と安定的に品質を確保する品質管理能力は当社の事業において必要不可欠である。安定した工程管理、品質検証、品質改善に取り組み、また品質管理体制の強化を継続的に進める。

### 価値創造

### 研究開発

#### 【特定の背景】

当社は精密研磨分野でのリーディングカンパニーとして、長年にわたって研究開発を続けてきた。今後も更なる微細化が進む半導体の最先端分野で最高の品質、性能へ絶えず挑戦し続け、お客様の要求に合致した製品の開発・提供をタイムリーに行う。

また同時に、研磨材開発で培った独自技術を活かし、サステナブルに貢献する新規用途開拓を推進する。

47

### 価値創造

### DX推進

#### 【特定の背景】

当社はDXを推進し、組成開発力の強化、生産性の向上、品質管理能力の向上、効率的な人材活用などを目指している。今後はDX推進のための体制整備を図り、全社を挙げて推進する。

### 価値創造

### 生産性向上

#### 【特定の背景】

お客様の需要に安定的に応え、また、少子高齢化や労働人口減少への対応のため、生産性の向上は重要な課題である。現工程の見直しや最適化、バリューチェーンの最適化、DXの活用などにより生産性の向上に努める。

48

技術を磨き、心をつなぐ

**FUJIAI**

**FUJIMI INCORPORATED**